

感應耦合式電漿蝕刻系統

(Inductive Couple Plasma Etcher, ICP Etcher)

注意事項

1. 執行HAR相關程式時，每次Loop數以不超過100為限。
2. 蝕刻累計300 Loop後，請以原載片執行Clean_HT 1次(至少300 sec)。
3. 執行Isotropic相關程式時，每次時間最長300 sec為限。
4. 使用完後，請以原載片執行Clean_HT_Su 1次(600 sec @ 10°C)，徹底清潔腔體。
5. 使用後請將Loadlock chamber 抽真空。
6. 為使機台能順利運作，請依規定操作。
7. 機台端備有數片載片，供使用者交替使用，如使用者發現載片有穿孔狀況，請將穿孔載片標註(X)符號，並自行更換新載片使用。

實驗室機台設備安全宣告

8. 操作期間無論發生有感地震、停電、毒氣或火災警報的狀況時，所有的人必須立即循逃生方向撤離實驗室。
9. 遇有氣體外洩、火災燃燒或人員傷害等緊急狀況時，請通知**緊急應變指揮中心協助處理(分機 7761& 7762)**。
10. 確認使用該機台可能需要防護具的使用方法及其所在位置，例如：緊急沖淋器、空氣呼吸器、滅火器、藥膏等。
11. 此系統只允許使用矽基板的核可使用者才能操作。
12. 實驗條件之設定狀況不得超過原有之設定範圍（如氣體流量，製程溫度以及製程壓力…等）。
13. 請注意工程師公告機台設備相關之停用製程或服務功能。如有發現其他同學不按照規定使用機台設備（未登記使用紀錄、未依SOP操作，使用不被允許或其他可能造成機台損壞的物料），請儘速告知工程師（**7651 or 7557**）處理或工安人員（分機**7737**）。
14. 機台設備如果有不能正常工作的狀況時，請先查閱之前紀錄且將發生狀況說明於紀錄簿上，並於工程師的電話中留言，工程師會儘速診斷原因並予以回應。
15. 在你離開前，請注意再確認機台所有的組件及模組，製程氣體流量和溫度是否設定回待機模式。並且，詳實填寫實驗紀錄簿。
16. 任何人若不遵守以上指示將會依**管理規則**懲處。